

Technical Data Sheet

聚氨酯导热结构胶

SP284



SP284是一款无溶剂、环保型、高强度、双组分聚氨酯导热结构胶，具有优异的粘接性和耐老化性能。

主要用途

- 1.新能源汽车模组结构导热粘接；
- 2.电子行业导热粘接；
- 3.工业、轨道交通等领域中各种基材的导热粘接。

产品特性

- 1.导热系数 1.2W/m.k，热阻低，热传导效率高；
- 2.高强度、高韧性；
- 3 粘度适中、设备磨损低，可设备点胶或胶枪施胶。

技术参数

固化前特性

A 组分—树脂			
性能	标准	范围	典型值
颜色	目测	蓝色	—
粘度 mPa.s Brookfield,7#, 10rpm	GB/T 2794	60000-140000	94800
密度 g/cm ³	GB/T 13354	1.55±0.1	1.60

B 组分—固化剂			
性能	标准	范围	典型值
颜色	目测	黄色	—
粘度 mPa.s Brookfield,7#, 10rpm	GB/T 2794	100000-200000	173200
密度 g/cm ³	GB/T 13354	1.90±0.1	1.90

混合特性

性能	标准	范围	典型值
配比	体积比	A:B=1:1	—
颜色	目测	绿色	—
粘度 mPa.s Brookfield,7#, 10rpm	GB/T 2794	80000-170000	145000
密度 g/cm ³	GB/T 13354	1.75±0.1	1.75
可操作时间 min	—	30-40 (可调)	30

Technical Data Sheet

聚氨酯导热结构胶

SP284



固化后特性

性能	标准	范围	典型值
拉伸强度 MPa	GB/T 528	≥ 8	9.0
伸长率 %	GB/T 528	≥ 15	20
剪切强度 MPa 3003 铝-3003 铝	GB/T 7124	≥ 8	9.5
剪切强度 MPa 3003 铝-PET 膜	GB/T 7124	≥ 1.5	2.2
硬度 Shore D	GB/T 531.1	65 ± 5	65
导热系数 W/m.k	ASTM D 5470	1.2 ± 0.1	1.25
体积电阻率 $\Omega \cdot \text{cm}$	ASTM D 257	$\geq 10^{14}$	2×10^{15}
阻燃性能(UL-94)	ANSI/UL-94	V-0	V-0
工作温度 $^{\circ}\text{C}$	—	$-40 \sim +80$	—

以上典型值数据均为 25 $^{\circ}\text{C}$ 标态下检测数据

使用说明

基材预处理

清洁待粘接表面，使基材表面干燥，清洁。

施工

双管包装：使用时装配静态混合管，进行混胶操作，挤出 8-10cm 长度的初始混合物，确保混合均匀。

5 加仑及 55 加仑桶装可使用专用计量设备，若您需要供胶系统，可联系 SEPNA 公司，提供技术支持及解决方案。

储存须知

8-28 $^{\circ}\text{C}$ 阴凉干燥环境密封存储。 贮存期：6 个月。

包装规格

400ml/双管

5 加仑

55 加仑。

注意事项

未用完的产品应立即密封保存，防止吸潮。

远离儿童存放。

建议在通风良好处使用。

若不慎接触眼睛和皮肤，请立即用清水冲洗，并到医院检查。

产品的安全性资料请参阅本产品 MSDS。

特别说明

本资料表中的数据是实验室条件下获得。由于使用条件的差异，使用者有责任根据自身使用条件对本产品进行测试和验证。江苏三纳科技材料有限公司（下文简称：三纳科技）不承担销售三纳科技产品和特定工况下使用三纳科技产品出现的问题，不承担直接、间接或意外损失责任。用户在使用过程中遇到什么问题，可以和三纳科技技术服务部门联系，我们将为您提供一切服务。